

Sendvičové prvky HPL

Typ: HPL-XPS/HD



Krycí vrstvy:

HPL- vysokotlaká vrstvená deska
podle DIN EN 438
s 200µ **MBAS dekoracním fóliovým**
povrchem, povrchy chráněny fólií

- o Odolná vůči UV záření a povětrnostním podmínkám
- o Viz přehled dekorů

Jádro:

tuhá polystyrénová pěna, extrudovaná

- o Skupina tepelné vodivosti 029
- o Hustota 32 kg/m³
- o Pevnost v tlaku 0,30 N/mm² podle DIN 53421
- o Odolnost vůči vlhkosti
- o Bez měkkých a tvrdých freonů

Krycí vrstvy	mm	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Materiál jádra, XPS-D	mm	16	20	21	26	29
Tloušťka desky	mm	20^{±0,5}	24^{±0,5}	25^{±0,5}	30^{±0,5}	33^{±0,6}
Koeficient prostupu tepla	W/m ² ·K	1,36	1,14	1,10	0,92	0,84
<small>*Počítáno s λ_D podle DIN EN 13164</small>						
Hmotnost	kg/m ²	7,2	7,4	7,4	7,6	7,7
Hodnota zvukové izolace	dB	30²	30²	30²	30²	30²

λ_B podle DIN 4108-4 a další jádra XPS dle požadavku.

²laboratorní hodnota

¹0,029 W/m·K

Formáty: 2150x900 / 2150x1150 / 3050x1150 mm
třída 1 (-)

Jiné rozměry a provedení dle poptávky.



Nárazová kyvadlová zkouška podle DIN EN 12600

íft zkušební zpráva **213 33639**

Celoplošný lepený spoj materiálových komponent pevný ve skluzu a tahu umožňuje samonosné použití sendvičových prvků **COSMO Tech**. Je třeba bezpodmínečně dodržovat naše pokyny k vestavbě a zpracování (99.0001)! Meze tolerance sendvičových komponent podle DIN popř. EN.

Struktura prvků neodpovídá směrnici GKV (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. (Ústřední svaz zpracovatelů plastů)) (stav prosinec 2002).

Naše pokyny k používání, směrnice k vestavbě a zpracování, údaje o produktu a fungování jsou pouze doporučení, jsou pokládány za nominální hodnoty za standardních testovacích podmínek. Popisují naše výrobky a výkony, v právním slova smyslu nepředstavují žádnou záruku. Kvůli rozličným účelům použití a různým podmínkám v místě musí uživatel provést své vlastní zkoušky ke zjištění vhodnosti v konkrétním případě použití. Naše aplikačně technická podpora není závazná a je realizována bez převzetí záruky. Vyhrazujeme si změny ve smyslu technického pokroku.